

■ 6 포인트 요약

1. 2Q23 수요 B/G 큰 폭 증가 전망

DRAM 2Q23 B/G: +두자릿수% 증가

NAND 2Q23 B/G: +두자릿수% 증가

1분기 감소분을 초과하는 출하량 성장 기대

2. 재고 및 재고평가 손실

SK하이닉스 재고: 1분기는 감산에도 불구하고 큰 폭의 판매량 감소로 인해 동사 완제품 재고는 DRAM, NAND 모두 QoQ 증가. 그러나, 생산 조절 및 2분기 B/G 고려시 동사 재고는 상반기 Peak 이후 감소할 것으로 전망

고객사 재고: 전반적으로 줄어들고 있으나, 일부 응용 고객사의 경우 여전히 높은 수준의 재고 보유. 내년 제한적 공급 증가를 우려한 안전재고 확보 전략의 일환으로 판단

경기 민감한 컨슈머 고객들은 긍정적 수요 감지되기 전까지는 보수적 태세 유지할 것으로 전망되며 상황 개선 시 빠른 구매 태세 전환 기대

재고평가 손실: 1Q23 1조원 정도의 재고평가 손실 계상 그러나, 2Q23을 정점으로 재고 감소할 것으로 예상되고, ASP 하락폭도 대폭 축소 전망하기에 2Q23 재고평가손실 규모는 상당부분 줄어들 것으로 전망

하반기 재고의 점진적 감소 및 가격 안정화에 따른 재평손 환입도 예상하고 있어 손익 회복도 가속화 될 것으로 판단

3. 생산량 조절 계획

수급 안정화 및 재고 적정수준이 될 때까지 현재의 보수적 생산계획을 유지해서 실행해 나갈 계획

4. 현금흐름

이후 분기는 투자 축소에 따라 현금 유출은 상당히 제한될 것으로 판단되고, 매출 성장 및 재고 축소되면 현금 유입 예상되는 바 2Q23 이후 안정적인 현금 보유 및 관리 예상

5. 고용량 고스펙 DRAM 수요 성장률 大

DDR5 128GB 이상 서버 모듈 23년 6배 증가 전망

HBM 매출액 성장률 23년 YoY +50% 예상

이미 수주 마쳤다고 판단. 내년에도 성장률 유지 예상

6. 삼성전자 감산에 따른 고객 반응

고객들의 확연한センチメント 변화는 부재하나

2분기에 일부 수요를 적극적으로 대응해야 하는지에 대한 문의를 하거나, 현물가격 안정화 이후 계약가격 안정화 여부에 대해 문의하는 고객들이 나타나고 있음.

=====

[1Q23 경영실적 요약]

□ 영업이익: -3.4조원(적자폭 확대)

매출원가, 판매 및 일반관리비 감소

급격한 매출 감소 및 재고평가손실 규모 확대 영향 반영 EBITDA 1,540억원 흑자

□ 응용별 실적 및 하이라이트

· DRAM

B/G: QoQ -20%

ASP: QoQ -10% 후반

· NAND

B/G: QoQ -10% 중반

ASP: QoQ -10%

악화된 NAND 시황에 따라 보수적 판매 전략. ASP 방어

□ 재무상태

현금보유: 6.14조원(QoQ -3,000억원)

차입금: 28.8조원(QoQ +5.8조원)

[향후 시장 전망]

1분기 지나며 고객들의 재고 수준 감소하고 있고, 공급업체의 감산효과 시작 전망
하반기로 가며 수급상황 개선될 것으로 기대
금년도 공급 조절의 영향으로 내년 호황기의 개선폭이 상당히 클 것으로 기대

□ Bit growth 전망: 수요 전망치 하향 조정

· DRAM

(기준) 23년 B/G 수요 +10% 초반

(신규) 23년 B/G 수요 한자릿수 중후반

2Q23 B/G +두자릿수% 증가(1분기 감소분 초과)

전분기 대비 의미 있는 매출증가 가능할 전망

서버向 DDR5/모바일向 LPDDR5 수요에 적극 대비

1nm 전 제품 수율 안정화 구간 도달

· NAND

(기준) 23년 B/G 수요 +20% 초반

(신규) 23년 B/G 수요 10% 중후반

2Q23 B/G +두자릿수% 증가(1분기 감소분 초과)

176단 SSD/uMCP 제품의 판매 확대 계획

176단 전 제품 수율 안정화 구간 도달

□ 응용별 수요 전망

· PC

작년에 이어 올해에도 출하량 역성장 예상
Consumer PC 수요 약세가 두드러지나, 고성능 노트북/
게임용 PC 판매 확대로 메모리 채용량은 증가

· Mobile

일부 유통채널 재고 감소 목적 중
중국 경기회복 효과와 주요 고객 신제품 출시로 하반기
수요 개선 기대
소비자 가격 민감도가 낮은 Flagship 중심 채용량 증가
일부 중화권 고객의 차별화를 위한 16GB 이상 LPD5X
/9.6Gbps Turbo 등 고용량/고성능 제품 관심 증가

· Server

IT 투자 위축/CSP 업체 재고 조정 영향으로 올해 수요는
다소 둔화
현재 고객들의 재고는 대부분 DDR4. DDR5 중심 고객
수요 변화 예상
Large Language Model/생성형 AI 기술개발과 사업화를
위한 경쟁이 치열해지며 고용량 모듈 수요 크게 증가

[Capex 전망]

- '23년 투자 전년 대비 50% 이상 축소하여 집행 중
- 경쟁력 유지를 위한 필수 투자를 제외하고 전 영역 투자 최소화
- DDR5/LPDDR5와 HBM3 등 수요 성장을 주도할 제품 생산을 위한 투자는 지속하여 하반기/내년 시장 대비
- 연내 DRAM 1bnm/NAND 238단 양산성 확보
- '22Q4 中 Legacy 및 저수익성 제품 중심 Wafer 투입량 축소,
- 올해 중 재고 정상화 이뤄질 것으로 전망

[Tech roadmap]

1bnm/238단 양산 준비 완료하여 기술경쟁력 유지

- 1bnm는 1nm 대비 Net die 효율성 크게 개선, EUV 공정 적용을 확대하여 공정 효율성 극대화
- 초기 Test에서 높은 수율 확보

1nm 기반 DDR5 full line-up 상의 우위

- 빠른 출시를 통해 최대 제품 인증 획득, 업계 유일 1nm 기반 128GB 이상 고용량 모듈 공급 가능
- '23년 DDR5 128GB 이상 고용량 서버 모듈 매출 전년 비 6배 이상 성장 예상

HBM 시장 내 압도적 점유율과 제품경쟁력

- 세계 최초 12단 적층, 현존 최고 용량 24GB HBM3 개발 완료 TSV 기술 적용, 16GB 제품과 동일한 높이로 구현, 제품경쟁력 강화

· '23년 HBM 매출 전년비 50% 이상 성장 예상

※ 주요 질의응답

Q1) 응용별 수요 둔화 현황

A1) 전체적으로는 가격 하락에 따른 채용량 증가, 일부 고객의 재고 소진, 중국 경기회복 기대 등으로 기존 전망 대비 개선될 것으로 예상 했었으나, 매크로 불확실성 지속되며 수요 전망 하향 조정

전용용 출하량 성장 둔화되고 있음 서버, PC, 스마트폰 모두 YoY 감소 전망

다만, 채용량 증가 및 고용량화 추세는 연초 예상과 비슷한 수준.

최근 몇 년간의 흐름을 봤을 때 1Q23이 세트 출하량 측면에서 저점이라고 판단. 하반기 전반적으로 개선될 것으로 전망

스마트폰의 경우, 하반기 핵심 포인트는 고용량화 기반의 판매 확대 추진

PC의 경우, 컨슈머, 커머셜 공히 상황 어려우나, 코로나때의 크롬북 특수 및 고객 경험에 따라 교체주기 도래 판단
생성형 AI 관련 고용량 HBM 수요가 매우 빠르게 늘고 있어서 올해 내년 사업환경에의 긍정적 요인으로 작용

Q2) SK하이닉스 재고 수준과 고객사 응용처별 고객 재고

A2) 1분기는 감산에도 불구하고 큰 폭의 판매량 감소로 인해 동사 완제품 재고는 DRAM, NAND 모두 QoQ 증가
그러나, 재고 많은 제품 중심으로 생산 조절하고 있고, 2분기 판매량도 1분기 감소폭 초과회복 예상되기 때문에 동사 재고는 상반기 Peak 이후 감소할 것으로 전망

고객사 재고는 전반적으로 줄어들고 있으나, 일부 응용 고객의 경우 여전히 높은 수준의 재고 보유. 내년 제한적 공급증가를 우려한 안전재고 확보 전략의 일환으로 판단

경기 민감한 컨슈머 고객들은 긍정적 수요 감지되기 전까지는 보수적 태세 유지할 것으로 전망되며 상황 개선 시 빠른 구매 태세 전환 기대

Q3) DRAM과 NAND 공히 두자릿수 B/G 예상하셨는데, 이 부분이 실수요 개선인지? 재고 축적 정책의 일환인지?

A3) 1분기는 경기 둔화로 고객 재고 소진이 진행되었기에 DRAM, NAND 큰 폭 역성장 기록
2분기 출하량 증가의 배경은, 상당부분 고객들의 보유재고 수준이 Peak out 되고, 하반기 빌드업 수요 개선을 대비한 영향이며 제품별로는 다소 상이함

고용량 중심 DDR5 수요는 실수요 베이스로 크게 늘고 있고, 고용량 모바일 및 그래픽 제품도 실수요 베이스로 늘고 있음.

다만, 컴퓨팅 DDR4 제품은 재고 이슈로 2Q23에도 수요 약세 전망

1Q23 B/G 감소분은 재고조정에 따른 과도한 B/G라고 판단하며, 2분기 B/G 늘어나는 부분은 그런 관점에서 정상화의 일환이라고 판단

Q4) 추가적인 감산 규모와 대상은?

A4) 현재 메모리 업계의 수급 불일치와 이로 인한 재고 수준은 정도와 규모 면에서 과거의 어느 때보다 심각한 상황이라고 판단. DRAM 조차 업계 전반 적자를 면치 못했고, NAND 적자폭은 심화되고 있는 상황

현재의 수요 상황을 고려하면 2Q23에도 급격한 가격 상승은 기대하기 어렵다고 판단하고 있음. 상황을 반영해 재고가 많은 제품을 중심으로 탄력적으로 생산 및 웨이퍼 투입량 조절 중

업계의 감산 효과가 2Q23 부터 본격적으로 나타나 3Q23 부터는 시황 개선과 함께 수급 정상화 예상

수급 안정화 및 재고 적정수준이 될 때까지 현재의 보수적 생산계획을 유지해서 실행해 나갈 계획

Q5) AI서버 메모리 시장 전망 및 SK하이닉스의 준비 상황

A5) 워크로드라는 변수가 있어서 Range가 넓기는 하지만, 동사는 베스트 케이스 시나리오로 판단. 향후 성장세는 견조할 것으로 판단

서버 출하량과 메모리 성장률은 통상 대비 40% 이상으로 향후 5개년간 성장 예상 메모리 금액 기준으로는 향후 5년간 30% 성장하는 시장으로 판단.

DDR5 128GB 고용량 모듈 및 HBM 각각 6배, +50% 이상 성장 예상하며, 이미 수주 마쳤다고 판단. 내년에도 동일 성장을 예상

DDR5 256GB 모듈까지 차질없이 준비하고 있고, HBM의 경우 올 하반기 8Gbps HBM3E 샘플 준비 차질없음

Q6) 향후 현금흐름에 대한 동사의 전망

A6) 1Q23 현금흐름은 매출감소와 영업적자 확대에 따라 EBITDA 크게 감소, 재고도 증가하며 운전자본 증가, 작년 실적에 따라 구성원에 PS 인센티브 지급되며 영업현금흐름 -2조원 기록. 추가해서, 작년 입고된 일부 장비의 취득금액이 3조원 가량 반영되어 있음.

이후 분기는 투자 축소에 따라 현금 유출은 상당히 제한될 것

으로 판단되고, 매출 성장 및 재고 축소되면 현금 유입 예상되는 바 2Q23 이후 안정적인 현금 보유 및 관리 예상

Q7) 최근 경쟁사 감산 발표로 인해 고객의センチメント 변화가 있는지?

A7) 고객들의センチメント 변화가 확연하다고 말하기는 어려우나, 몇 가지 변화가 있기는 한데, 하반기 준비를 위해 2분기에 일부 수요를 적극적으로 대응해야 하는지에 대한 문의를 하거나, 현물가격 안정화 이후 계약 가격 안정화 여부에 대해 문의하는 고객들이 나타나고 있음.

제품별로는 고성능 LPDDR5, 서버 DDR5 등의 제품에서 공급 안정성 확인 차원에서의 문의가 들어오고 있음

Q8) 올해 이자비용이 어느정도 될지? 올해와 내년 만기되는 차입금 규모가 어느정도 되는지?

A8) 23년에도 고금리 기조 유지될 것으로 판단하고 있음. 23년 신규 차입 실행을 고려해 봤을 때, 23년도 이자비용은 작년보다 2배 증가한 1조원 규모로 예상
향후 3년간 연평균 만기도래 차입금은 4 ~ 5조 이내

다가올 업턴에 대해서도 투자와 비용의 효율적 관리를 통해 장기적으로 차입금 규모를 줄여나갈 예정

Q9) 최근 미국 정부의 반도체 법 관련해서 가드레일 발표에 따라 중국에서의 신규 캐파 증설 어려울 것 같고 공정 전환 가능할 것 같은데, 중국 팹 운영 계획?

A9) 장기적 리스크, 팹 효율성 등 종합적 고려해서 다각적으로 검토 중

현재 상황에서는 중국 팹 운영의 관점에서 큰 변화는 없는 상황. 장비수출 통제에 대해서도 유예를 긍정적으로 바라보고 있고 최대한의 노력 경주

Q10) 재고자산 평가손실 1Q23 어느 정도이고, 2Q23 전망에 대해

A10) 1Q23에는 4분기 대비 재고 증가 및 가격 하락에 따라 1조원 정도의 재고평가 손실 계상

그러나, 2Q23을 정점으로 재고 감소할 것으로 예상되고, ASP 하락폭도 대폭 축소 전망하기에 2Q23 재고평가손실 규모는 상당부분 줄어든 것으로 전망하고 있음

올 하반기에는 재고의 점진적 감소 및 가격 안정화 예상하고 있어 재평손 환입도 예상하고 있어 손익 회복도 가속화 될 것으로 판단

Q11) DDR5 제품의 품질 측면 우월성의 배경? DDR4 대비

수익성 차이가 얼마나 되는지?

A11) 18년 세계 최초 16Gbit DDR5 개발, 24Gbit DDR5 개발, 6400Mbps 개발 등 시장 선도. 업계에서 가장 먼저 관련 모듈 부품 공급 및 품질 안정성 확보를 선제적으로 할 수 있고, 신뢰성 검증 등도 선행적으로 진행 가능

제품 공급력 측면에서 서버의 경우 DDR5 크로스오버가 내년 2분기, PC의 경우 내년 1분기로 예상. 동사의 경우 올 하반기 크로스오버 예상

DDR4 대비 수익성은, 두 제품사이의 비용 구조는 완전히 다름. BOM이 많이 올라가기 때문. 그럼에도 불구하고 둘 사이의 제품가격 갭이 커지지 않도록 계획 중

Q12) HBM 사업전망 및 경쟁사 대비 우위의 요인은?

A12) 우수한 설계역량 기반의 성능적 측면과 업계 최고 수준의 품질, 선제적 투자 관리, 글로벌 관련 SOC 리더 및 잠재 고객인 클라우드들과의 협업.

5.6Gbps에 이어서 올 하반기 8Gbps HBM3E 개발 및 내년 상반기 양산 계획

TSV 적층 과정에서의 단열이 핵심 기술. 가장 우수한 경쟁력 보유. Capa도 매년 50% 이상의 성장에 대비할 수 있는 Capa를 선제적으로 준비해 놓고 있음

지금까지는 SoC 업체 중심의 성장이었다면, 앞으로는 클라우드 업체들도 잠재 고객 및 협업 진행 중

Q13) NAND 수익성 회복 방안은? 4분기 대련관련 2,000억 원 추가비용 되었던 것과 관련해 이번분기 환입 및 추가 여부?

A13) 과거 수년간 10% 정도의 상대적으로 적은 규모 유지해 왔고, 제품 포트폴리오도 경쟁사와의 격차 존재 했었음. 이러한 격차를 보완하기 위해 규모의 경제 확보, 경쟁사 대비 높은 176단 비중을 통해 원가 경쟁력 캐치업, 업계내 구조적 개편 가능성 하에 M&A 추진

그 결과로 동사 NAND 점유율 20% 수준으로 올렸고, 제품 포트폴리오도 모바일 중심에서 SSD로 다변화 할 수 있었음

작년의 경우, 솔리다임 인수 첫 해인만큼 제반 비용 및 PPA로 회계처리에 따른 비경상적 비용 발생으로 실적에 부담된 것이 사실

176단 비중 확대로 제품 경쟁력 확보했으나, 비용발생 지속되며 당분간 NAND 사업 어려운 국면 예상

전사 차원의 Capex, Opex 최적화. 중복영역 제거 등 비용효

율화에 집중하고 있음

비용인식과 관련해, 지난분기 인식 시점 측면에서 차이가 나는 부분을 얘기한 것 같음. 이번 분기에도 약간의 차이가 있어 이번 실적에는 반영되지 않은 상황임.

Q14) HBM 좋은데, BOM도 높은데 시클리컬에서 수주형 산업으로 육성할 수 있는 전략과 계획이 있는지?

A14) HBM은 ChatGPT 등 영향으로 고속 성장. 고객수가 제한적이고, HBM3 공급 가능한 업체도 거의 없는 상황 한정적 고객을 대상으로 적정 가격을 받을 수 있는 비즈니스 모델 변화를 생각해 볼 수는 있음.

가능하다면 이익의 변동성 완화 및 성장 가시성 확보될 수 있을 것으로 기대 중

= 끝 =